

●スパッタリング装置 SSP



【構成内訳】

1. 成膜用チャンバー
2. ロードロックチャンバー
3. スパッタ源
4. 真空計
5. ガスライン各種
6. 架台
7. 制御システム

【特長】

- 本装置は、薄膜を作成する為の高真空成膜スパッタ装置です。
- 成膜室を大気に暴露することなく試料交換可能なロードロック方式となっております。
- 膜中への不純物混入を抑制するため、成膜室は超高真空対応です。
- 本装置で装備しているスパッタは、RF式であり、最大で4基まで搭載可能です。
- チャンバーサイズ及び、ポート数、フランジ規格、表面処理、排気系等はご要望にあわせ作製が可能です。

※上記写真は標準品の写真になります、実物は仕様に合わせての作製になります。

【仕様】

チャンバー：丸型、角型等

材質：各種ステンレス

表面処理：

GBB、電界研磨、内面鏡面研磨等

基板：各種サイズ、加熱・冷却機構等、回転機構等

オプション：各種有り

※よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含み下さい。